

证券代码：301200

证券简称：大族数控

深圳市大族数控科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-003

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中信证券策略会（6月1日） 大家资产（6月8日） |
| 时间 | 2023年6月1日-2023年6月8日 |
| 地点 | 合肥洲际酒店 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、财务总监兼董事会秘书：周小东 证券事务代表：周鸳鸯 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、公司所处 PCB 行业情况</p> <p>受全球地缘政局不稳定等影响，全球通货膨胀加剧，消费者信心指数大幅下滑，自 2022 年中旬至今，电视机、个人电脑、平板、手机等大宗消费不振，尽管服务器及存储器、通讯设备领域、工业领域、汽车电子等方面需求有所成长，但 PCB 市场整体需求依旧不足，从而影响下游客户的投资力度和进度，专用加工设备市场受到较大的影响。</p> <p>但从中长期来看，PCB 产业作为电子信息基础产业不可或缺的一部分，未来在 5G 应用场景延伸、AI 内容生成、汽车自动驾驶等推动下，PCB 的需求量特别是高端 PCB 市场将恢复上涨态势，对高技术附加值专用加工设备需求提升，特别是国内市场，将带来更大的国产化替代市场空间。</p> |

二、公司战略规划

公司自成立以来始终专注于 PCB 专用设备行业，不断拓展 PCB 制造过程中技术难度大、附加值高的关键工序，持续为客户提供一站式解决方案；同时围绕专用加工设备的辅助工具、辅助材料及加工对象，重新打造价值链条，致力于“成为世界范围内最受尊敬和信赖的 PCB（装备）服务商”。

从深度上，公司从专注于设备本身效率及稳定性、自动化及智能化等方面的提升，嬗变至工艺解决方案的创新，针对现有设备业务，增加相应设备耗材、材料等，并结合设备、工艺参数、加工工具及原辅料等为客户提供最优的工序解决方案，同时通过单机自动化及工序自动化、工序一体化、上下游协同化的技术发展思路，不断更新全流程智能化生产模式，为下游 PCB 产业客户提供工序的一体化解决方案；从广度上，公司将充分挖掘现有产品上下游工序的价值，持续丰富产品矩阵，致力于为客户提供多制程前后品质一致的综合性解决方案。

三、多层板市场业务发展情况

公司在多层板市场具有较强市场地位，关键产品几乎可实现 100% 国产化替代；为进一步提升国内 PCB 企业的数字化水平，降低综合运营成本，公司持续加大产品创新力度，如迭代的自动化、智能化钻孔机方案，实现了钻房综合稼动率的显著提升，助力客户降本增效。另外公司将进一步拓展该市场的产品线，不断挖掘新的市场增长点，为客户提供内涵更为丰富的一站式解决方案，确保公司粮仓市场有稳固的业绩增长。

在高多层板方面，主要受通信设备、服务器、AI 加速器等高速应用推动，高速产品的信号完整性则对加工设备的精度有更高要求，驱动 CCD 六轴独立机械钻孔机、高层间对位精度激光直接成像机、大台面通用测试机及四线测试机等设备需求的增长。

四、在 HDI 市场的进展情况

5G 智能手机、汽车自动驾驶等终端不断提升 HDI 技术的难度，如叠层数增加、盲孔孔径减小及密度增加、高频高速材料的应用等，驱动 CO₂ 激光钻孔机、UV+CO₂ 复合激光钻孔机、高解析度激光直接成像机、高精测试机等设备需求的成长，且公司将 HDI 市场细分为不同终端应用，针对不同需求提供适当的解决方案，加上

| | |
|----------|---|
| | <p>国内电子终端品牌的供应链国产化替代需求提升，促进公司在该市场的增长。</p> <p style="text-align: center;">五、在 IC 封装基板领域的进展情况</p> <p>在应用于计算机、通讯类设备的 CPU、GPU、SoC、存储及射频类芯片等领域的 IC 封装基板市场，公司多类产品取得突破，部分产品进入高阶 FC-BGA 封装基板加工领域。新研发的高转速机械钻孔机、高精测试机产品获得国内多家龙头客户的认证并形成正式销售，而运用新型激光技术，开发用于高阶封装基板超高叠层、内埋高精度元器件等高阶封装基板工艺的方案，获得国际芯片厂商的技术认证；另外 CO₂ 激光钻孔设备在阻焊工序的开拓性应用，获得国内数家龙头企业的复购订单；最新研发的 ±2.5μm 综合对位精度的高精专用测试设备，可对标全球封装基板测试设备龙头企业 Nidec-Read 的主流机型，相关产品有望实现高水平的国产化替代。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2023 年 6 月 9 日 |